

奥野製薬工業(株) 展示会出展のご案内

記

会 期 : 2018年1月17日(水) ~ 19日(金)
 10:00 ~ 18:00 (最終日は17:00 終了)
 開催場所 : 東京ビッグサイト 東3ホール
 小間番号 : E24-28
 ご来場の際は、招待券をご持参下さいますようお願いいたします。

出展品目

◎最終表面処理関連

- ・ Roll to Roll装置に適したフレキシブル基板対応の無電解ニッケル/金めっきプロセス
- ・ ファインパターン対応高耐食性無電解ニッケル/置換金めっきプロセス
- ・ フレキシブル基板対応 無電解ニッケル/金めっきプロセス
- ・ 銅上への無電解金めっきプロセス
- ・ 銅上への無電解パラジウム/金めっきプロセス
- ・ パワーモジュール用無電解ニッケルめっき液

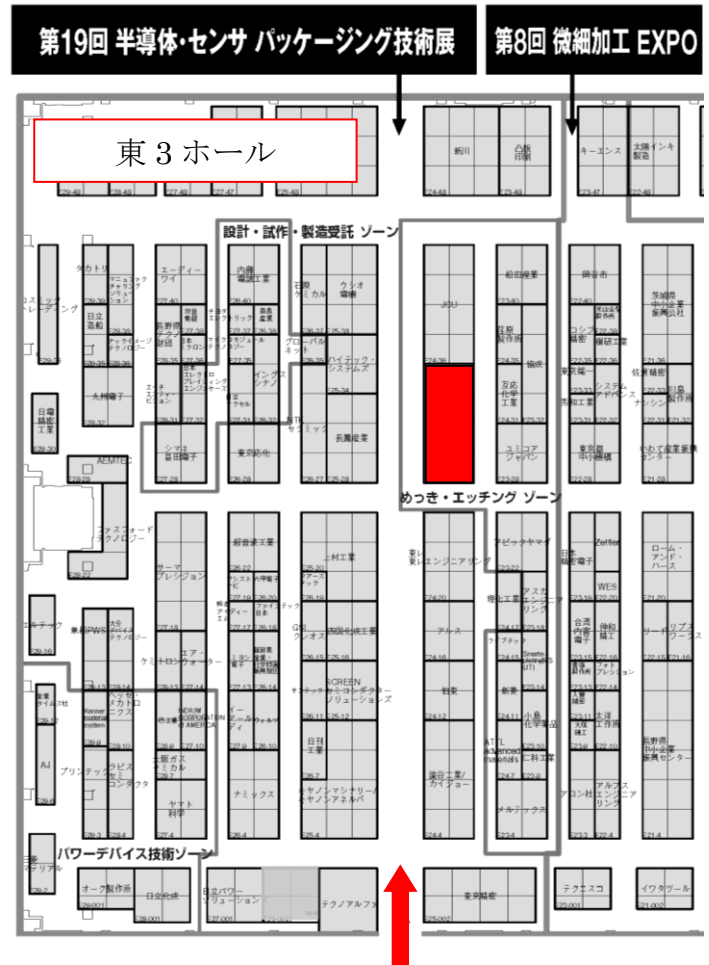
◎OPCプロセス関連

- ・ 接続信頼性に優れる無電解銅めっきプロセス
- ・ ナノ銀触媒を用いた無電解銅めっきプロセス
- ・ 先孔工法対応ポリイミドフィルムへのニッケルシード層形成プロセス
- ・ 銅素材への黒色化処理液/変色防止剤
- ・ 水平搬送用無電解銅めっきプロセス
- ・ 超微細回路形成および最終表面処理

◎硫酸銅めっき添加剤

- ・ 高電流密度対応ビアフィリング用
- ・ MSA Pに最適なビアフィリング用
- ・ レーザースルーホールフィリング用
- ・ 半導体ウエハ用

◎環境配慮型プリント配線板製造プロセス (福岡大学)



製品及び総合技術研究所紹介映像

- 「ナノ銀触媒を用いた無電解銅めっきプロセス～NACEプロセス～」
- 「硫酸銅めっき添加剤～トッパルチナシリーズ～」
- 「総合技術研究所紹介」

東3ホール 出入口

出展製品

◎最終表面処理関連

- ・ Roll to Roll装置に適したフレキシブル基板対応の無電解ニッケル／金めっきプロセス
「トップRRプロセス」
- ・ ファインパターン対応高耐食性無電解ニッケル／置換金めっきプロセス
「ICPニコロンHF P／フラッシュゴールド330H」
- ・ フレキシブル基板対応 無電解ニッケル／金めっきプロセス
「トップ ICP FEEL プロセス」
- ・ 銅上への無電解金めっきプロセス
「トップギルドプロセス」
- ・ 銅上への無電解パラジウム／金めっきプロセス
「トップパラスプロセス」
- ・ パワーモジュール用無電解ニッケルめっき液
「ICPニコロンLPD-LF」

◎OPCプロセス関連

- ・ 接続信頼性に優れる無電解銅めっきプロセス
「OPC FLETプロセス」
- ・ ナノ銀触媒を用いた無電解銅めっきプロセス
「NACEプロセス」
- ・ 先孔工法対応ポリイミドフィルムへのニッケルシード層形成プロセス
「トップSAPINAプロセス」
- ・ 銅素材への黒色化処理液／変色防止剤
「OPCブラックカッパー／OPCブラックキープ」
- ・ 水平搬送用無電解銅めっきプロセス
「OPC H-TECプロセスNEXT」
- ・ 超微細回路形成および最終表面処理
「トップUFPプロセス」

◎硫酸銅めっき関連

- ・ 高電流密度対応ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤
「トップルチナHV」
- ・ MSAPに最適なビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤
「トップルチナVT」
- ・ レーザースルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤
「トップルチナLTF」
- ・ 半導体ウエハ用硫酸銅めっき添加剤
「トップルチナCP」「トップルチナSV」

◎環境配慮型プリント配線板製造プロセス（福岡大学）

「EF-PWB PROCESS」